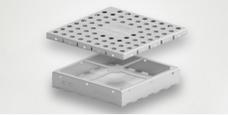




HANDHELD

SPEZIFISCHE ANWENDUNG:

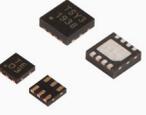
- Multimeter
- Protokollanalysator
- Leistungsmesser
- Netzwer-Testgeräte
- Geräte für die Störfestigkeitsprüfung

Produkt	Eigenschaften	Vorteile	Produktfamilie
Leiterplatte-zu-Leiterplatte			
0.5, 0.6, 0.8 mm freie Höhe 	<ul style="list-style-type: none"> Ermöglicht hohe Kontaktanzahlen auf kleinstem Raum, um wertvollen Platz auf der Leiterplatte zu sparen. Erhältlich in den Kontakt-Konfigurationen 220, 240 und 440. Verfügbar in einer Vielzahl von Stapelhöhen von 5 bis 8 mm. Erhältlich in Tape&Reel-Verpackung für den Schutz der Anschluss-Kontakte und für die automatisierte Bestückung. Von Intel für COM Express qualifiziert 	<ul style="list-style-type: none"> Ermöglicht hohe Kontaktanzahlen auf kleinstem Raum, um wertvollen Platz auf der Leiterplatte zu sparen. Verfügbar in einer Vielzahl von Stapelhöhen von 5 bis 8 mm. Erhältlich in Tape&Reel-Verpackung für den Schutz der Anschluss-Kontakte und für die automatisierte Bestückung. Kompatibel mit Standard-Pick-and-Place-Vakuumdüsen Verfügbar mit UL- und RoHS-konformen Teilen 	Leiterplatte-an-Leiterplatte-Steckverbinder
MICTOR (12G) Steckverbinder 	<ul style="list-style-type: none"> Zweiteiliger Steckverbinder für eine Vielzahl von Leiterplatten-Stärken, bietet kontrollierte Impedanz Hybridsteckverbinder mit spezieller Erdungsschiene für Low Crosstalk oder als Stromanschluss; jeder Power Kontakt trägt 9,5 A 12-Gbit/s High-Speed Datenrate 0,8-mm-Raster für die SMD Montage Verschiedene Stapelhöhen von 5 mm bis 30 mm; verfügbare Stapelhöhen: 5, 8, 11, 14, 16, 19, 22, 25 und 30 Anzahl Kontakte von 28 bis 200; voll bestückt: 40, 80, 120, 160 und 200; nicht voll bestückt: 28, 56, 84, 112, und 140 	<ul style="list-style-type: none"> Zuverlässige Signalintegrität und ausgezeichnete Signalgeschwindigkeit Freie Pinbelegung mit einer großen Auswahl an Optionen für kundenspezifische Systemdesigns Robustes und intelligentes Gehäusedesign Kundenfreundliche Preisgestaltung, kürzere Vorlauf- und Reaktionszeiten 	Leiterplatte-an-Leiterplatte-Steckverbinder
M.2 	<ul style="list-style-type: none"> 0,5-mm-Raster mit 67 Kontakten Entwickelt für ein- und zweiseitige Module Erhältlich in verschiedenen Kodierungsoptionen für Modulkarten Unterstützt PCI Express 3.0, USB 3.0 und SATA 3.0 Höhe, Position, Bauart und Kodierung wählbar In verschiedenen Höhen erhältlich 	<ul style="list-style-type: none"> Die Produktlinie M.2 Next Generation Form Factor (NGFF) ist ein natürlicher Übergang von der Mini-Karte und der Halb-Mini-Karte zu einem kleineren Formfaktor in Größe und Volumen. WiFi, Bluetooth, globale Navigationssatellitensysteme, Near Field Communication, hybrides Digitalradio, Wireless Gigabit Alliance (WiGig), Wireless Wide Area Network und Solid State Storage Devices Ein weiterer Vorteil sind die PCIe-Gen-3-, SATA-3, SATA-I/O- und USB-3.0-Funktionserweiterungen. Der neue, kleinere Formfaktor eignet sich für Anwendungen in neuen schlanken Plattformen 	PCB-Steckverbinder
HF / Abschirmung / Erdung			
BNC, SMA, N, SMB, MHF 	<ul style="list-style-type: none"> Bajonettverschlusskupplung für ein schnelles Verbinden/Trennen Verschiedene Steckverbinder in 50- und 75-Ohm-Ausführungen erhältlich Vollständig kompatibel mit vergleichbaren BNC-UG/ U-Steckverbindern Umfassendes Sortiment an Hex Crimp- und O-Crimp Produkten für gängige Koaxialkabel. Niedriges Stehwellenverhältnis 	<ul style="list-style-type: none"> Entwickelt für Funkfrequenzen von wenigen MHz bis über 100 GHz HF-Steckverbinder sorgen für eine optimale Leistung in rauen, herausfordernden Umgebungen. Dabei gewährleisten sie eine geringe Einfügungsdämpfung, ein ausgezeichnetes Stehwellenverhältnis sowie weitere elektrische und mechanische Eigenschaften. 	HF-Koax-Steckverbinder
Board Level Shielding (BLS) 	<ul style="list-style-type: none"> Zweiteilige Lösung (Mindesthöhe 0,85 mm) Einteilige Lösung (Mindesthöhe 0,7 mm) Standardisierte Materialien und Blechstärken Zu den standardisierten Merkmalen zählen: Form der Ecken, Trägerbefestigung, SMT (Kastellierungen), Biegeradien, Bestückungseigenschaften, durchgehende Löcher, Rastlöcher, Verriegelungs- und Kontaktvertiefungen 	<ul style="list-style-type: none"> EMI-Abschirmungen, die das sogenannte Nebensprechen in komplexen Geräten minimieren, ohne die Systemgeschwindigkeit zu beeinträchtigen 	EMI-Filter
Federkontakte 	<ul style="list-style-type: none"> Umfangreiches Standardangebot an Federkontakten/ Erdungsprodukten Erhältlich in Höhen ab 0,4 mm und bis 7,0 mm Typ: Standard, seitlich geschützt, vorgespannt, ultra low-profile Die Vorspannfunktion verdoppelt fast den Arbeitsbereich eines herkömmlichen Federfingers und erhöht die Kontaktkraft um 0,2 N 	<ul style="list-style-type: none"> Dank winziger, skalierbarer, oberflächenmontierbarer Kontakte kann der Konstrukteur Erdungslösungen fast überall anbringen 	Leiterplatte-an-Leiterplatte-Steckverbinder

Produkt	Eigenschaften	Vorteile	Produktfamilie
Eingabe/Ausgabe			
<p>AMPLIMITE</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Höchste Beständigkeit gegen Entflammbarkeit mit einem nach UL94V-0 eingestuftem thermoplastischen Gehäuse, Schnittstelle Typ D mit hoher Dichte • 20 bis 100 Kontaktpositionen • Hervorragender EMI/RFI-Schutz • Schützen Sie Ihr System mit Abschirmungen, die vor den Kontakten gesteckt werden, wobei die Masse zuerst gesteckt und zuletzt unterbrochen wird • Je nach Bedarf sind Quetsch- oder Spindelverschlüsse erhältlich 	<ul style="list-style-type: none"> • Nutzen Sie umfassende Designoptionen, um praktisch jede Systemanforderung zu erfüllen, mit Kabel und rechtwinkligen oder geraden Leiterplattenkonfigurationen • Für maximale Designfreiheit mit einer Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten wie (Wellen-)Löten, Crimpen, IDC, Flachbandkabel und Action Pin • Robustes Design für den Einsatz in rauen Umgebungen • Verbessern Sie die Haltbarkeit mit Frontmetall-, Vollmetall- und Kunststoffgehäusen • Reduzieren Sie das Gesamtvolumen der Stiftleisten um 48 % und die Leiterplattenfläche um 38 %, mit gestapelten Stiftleisten, um mehr Platz für andere Komponenten zu schaffen • Ein grosses Portfolio an Kits und Zubehör erlaubt die Anpassung an spezifische Anwendungen • Optionale Kontaktabschirmung für zusätzlichen EMI/RFI-Schutz • In Übereinstimmung mit SCSI- oder VESA-Industriestandard • Ermöglichen Sie mit integrierten Leiterplatten-Verriegelungen oder Schraubsicherungsmuttern eine problemlose Montage der Steckverbinder auf der Leiterplatte 	<p>D-förmige Steckverbinder</p>
<p>USB A/C</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Unterstützt die Typen USB 2.0, USB 3.1 Gen 1 und USB 3.1 Gen 2 • Liefert eine Leistung von bis zu 100 W bei 20 V • IPX8-wasserdichte und IPX4-spritzwassergeschützte Optionen verfügbar • Erhältlich mit einer der kleinsten zweireihigen SMT-Gehäusegeometrien, sodass wertvolle Leiterplattenfläche eingespart wird 	<ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung einer Verbindungslösung für Daten, Stromversorgung und A/V • Entwickelt mit einer austauschbaren und umkehrbaren Steckschnittstelle • Abwärtskompatibel mit anderen USB-Anschlüssen bei Verwendung von Konverterkabeln oder Adaptern • Unverwechselbares Design auf der Rückseite des Gehäuses für branchenführende EMI-Leistung • Verbesserte Platinenhaltefunktionen für zusätzliche Haltbarkeit 	<p>USB-Stecker</p>
<p>RJ45</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • 30u Zoll Vergoldung • LCP-Materialien • Industrieller Temperaturbereich -45 bis +85 °C • Reflow lötlbar • 3-adrige Drossel • Datenraten von 10/100 Mbit/s und 1 Gbit/s • 1x1-, 2x1- und 1x2-Formfaktoren mit LED-Option erhältlich • PoE, PoE+ und PoE++ werden unterstützt 	<ul style="list-style-type: none"> • Verbesserte Zuverlässigkeit durch hohen Temperaturbereich der Magnetics, Hochtemperaturmaterialien (LCP) und eine 3-Zoll-Goldkontaktbeschichtung • Korrosionsbeständig durch vergoldete Kontakte • Industrieller Temperaturbereich für temperaturtechnisch nicht geregelte Anwendungen in der industriellen Fertigung • Ausgezeichnete Signalintegrität und minimale Sättigung sorgen für weniger Übertragungsfehler durch Verwendung einer dreiadrigen Drossel (keine Interferenz zwischen PoE und Signalen) • Verbesserte Verarbeitbarkeit, da bei der Geräteproduktion nur ein einziger Löt-Vorgang erforderlich ist • Optimierte Verpackung für den Produktionsablauf des Kunden durch T&R- und Tray-Verpackungen verfügbar 	<p>Steckverbinder</p>
Kabel-zu-Leiterplatte			
<p>FPC (0,4 BtB oder ZIF oder LIF)</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Raster: Raster 0,25 bis 1,25 • Anzahl Kontakte: 3 bis 60 Kontakte • Schräge FPC-Einfügeoption zur Maximierung der PCB-Layoutfläche • Low-Profile (unter 1 mm) und günstige Produktangebote • Umfangreiches Portfolio für mehr Design-Flexibilität bei bewährter Qualität und Zuverlässigkeit 	<ul style="list-style-type: none"> • Geeignet für FPC-/FFC-Kabel • Erhältlich als ZIF- und Nicht-ZIF-Ausführung • Verschiedene Rastmaßoptionen • Erhältlich mit SMT- oder T/H-Leiterplattenanschluss • Keine Werkzeuge erforderlich • Erhältlich in Ausführungen mit rechtwinkliger und vertikaler Montageausrichtung • Rechtwinklige Ausführung mit oberem, unterem oder Doppelkontakt erhältlich • Löt pads und abgewinkelte Beine zur Leiterplattenarretierung • Die Verriegelungsfunktion sorgt für hohe Haltekraft 	<p>FFC, FPC und Flachbandsteckverbinder</p>

Produkt	Eigenschaften	Vorteile	Produktfamilie
Kabel-zu-Leiterplatte			
High Performance Interconnects (HPI) 	<ul style="list-style-type: none"> • Raster: 1,0 mm – 2,5 mm • Positionen: 2 - 32 • Stiftkontakte mit quadratischem Querschnitt ermöglichen die Kompatibilität mit Industriestandardprodukten. • Umfangreiches Portfolio, geeignet für alle Anwendungen, bei denen Signale oder schwache Ströme in einem Gerät übertragen werden müssen 	<ul style="list-style-type: none"> • Hohe Zuverlässigkeit und Leistung • Rechtwinkligen Stiftkontakte erlauben Steckverbindungen mit Produkten anderer Hersteller • Stiftleiste + COSI Steckverbinder (Crimp On Snap In) • Polarisiert • Positive Arretierung mit hörbarem Klicken beim Stecken • Verschiedene Farben zur Systemfarbcodierung erhältlich • AWG 30-24 	Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbinder
CT, Mini CT, Micro 	<ul style="list-style-type: none"> • Zwei Anschlussmöglichkeiten: Schneidklemmkontakte, Crimpverbindung • Schneidklemmkontakte, AWG 26 - 28 • Crimp AWG 24-28 • Schaltkreise von 2 bis 20 einreihig und 20 bis 40 zweireihig • Optional geknickte Beine für bessere Fixierung auf der Leiterplatte • Drawer- und Lattice-Serie • Ausführung für Flanschmontage verfügbar • RoHS-konform • Komponentenprogramm der Underwriters Laboratories Inc., Aktenzeichen E28476 • Canadian Standards Association, Aktenzeichen LR 7189-133 	<ul style="list-style-type: none"> • Ähnlich wie die standardmäßige AMP-CT-Steckverbinderreihe, die sich bei der Herstellung von Kabelbäumen bewährt hat • Es gibt eine Vielzahl von Maschinen für die Kabelbaumherstellung, von Handgeräten für die Kleinserienproduktion bis hin zu automatischen Crimpmaschinen • Zwei Gehäusetypen sind verfügbar: Crimp- und MT- Gehäuse (Mass Terminated), die mit Schneidklemmkontakten vorbestückt sind 	Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbinder
Power			
Micro-USB-Steckverbinder 	<ul style="list-style-type: none"> • Zuverlässiges und robustes Design für eine stabile Verbindung, auch nach Tausenden von Steckvorgängen • Kosteneinsparungen durch die Integration von Strom- und Datentransport innerhalb eines Steckverbinders • Unser großes Portfolio und unser hochgradig anpassbares Produkt bieten die bestmögliche Designflexibilität 	<ul style="list-style-type: none"> • Kleiner Steckverbinder • Hohe Gestaltungsfreiheit • Erhöhte Robustheit und überlegene Haltbarkeit • Kosteneffiziente Lösung 	Audio- und Videoanschlüsse
DC-Buchse (Batterie, Gehäuse) 	<ul style="list-style-type: none"> • Geringe Größe für einfache Integration • Schnappfunktionen zum Verriegeln der DC-Buchse in der Abdeckung • Ein doppelt gefederter Massekontakt verbessert die Auszugskraft des Steckers • Laserbeschriftung zur Identifizierung 	<ul style="list-style-type: none"> • Breite Marktakzeptanz • Geringe Kosten und einfache Anwendung • Einfache Handhabung für Endkunden und weit verbreiteter Anschluss 	Batterie-Steckverbinder und Halterungen
Leiterkarten und Buchsen			
Mini SD 	<ul style="list-style-type: none"> • Unterschiedliche Steckerkonfigurationsgrößen: Standard und Micro • High-Speed-Datenübertragung • Entwickelt für eine unkomplizierte Bedienung mit den Steckmöglichkeiten Push/Push und Push/Pull • Konstruktionsbedingte Einhaltung der bestehenden SD-Speicherkarten-Standards • Erhältlich als Top- oder Bottom-Mount-Ausführung 	<ul style="list-style-type: none"> • Entwickelt für eine unkomplizierte Bedienung mit den Steckmöglichkeiten Push/Push und Push/Pull • Konstruktionsbedingte Einhaltung der bestehenden SD-Speicherkarten-Standards • Erhältlich als Top- oder Bottom-Mount-Ausführung 	Speicherkarten-Steckverbinder

Produkt	Eigenschaften	Vorteile	Produktfamilie
Relais			
AXICOM IM Relais 	<ul style="list-style-type: none"> Besonders flach 10 x 6 mm, flache Ausführung 5,65 mm und min. Leiterplattenfläche 60 mm² Schaltstrom 2/5A, Schaltleistung 60 W/62,5 VA und Schaltspannung 220 VDC/250 VAC Hohe Dielektrizitäts- und Überspannungsfähigkeit von bis zu 2500 Vrms zwischen offenen Kontakten und 2500 Vrms zwischen Spule und Kontakten. Geringer Spulenstromverbrauch, 140 mW Standard, 100 mW bei der hochempfindlichen Version, 50 mW bei der ultra-hochempfindlichen Version und 100 mW bei der bistabilen Version Hohe Kontaktsicherheit bis zu 10.000.000 Schaltzyklen Sehr geringer und stabiler Kontaktwiderstand THT, SMD-Design für Reflow-Löten, bietet eine Option mit kleinerem Footprint Hohe mechanische Stoßfestigkeit bis 50 g funktional 	<ul style="list-style-type: none"> Kleine elektromechanisches Relais, welche dem Platzbedarf von kontinuierlich schrumpfenden Kundenanwendungen genügen Verfügbare Kontaktstruktur-Optionen (1 Form A, 2 Form A, 1 Form C, 2 Form C), was bei alternativen Technologien wie Halbleiterrelais oft nicht ohne große Kostenfolgen möglich ist Schaltet Signal und niedrige Leistung Unterstützung batteriebetriebener Anwendungen durch eine bistabile Lösung, die keine konstante Leistung verbraucht 	Axicom Relais
Schalter			
Tastschalter 	<ul style="list-style-type: none"> Schalter geben taktile Rückmeldungen an Benutzer bei Kontakt mit dem Bedienfeld Erhältlich in verschiedenen Größen und Aktuator-Ausführungen LEDs möglich 	<ul style="list-style-type: none"> TE bietet eine große Auswahl an taktile Schaltern, von Miniatur-Oberflächenschaltern bis hin zu taktile Schaltern mit IP-Schutzart. Die taktile Schalter von TE sind in verschiedenen Aktuatorlängen erhältlich, die eine individuelle Funktion bieten, die in jede Designanwendung passt 	Schalter
DIP-Schalter 	<ul style="list-style-type: none"> Breites Spektrum an DIP-Schaltern für die Oberflächen- und Durchsteckmontage Eine Vielzahl von Aktuortypen und -Größen ermöglicht eine breite Palette von Anwendungen in Computern und Peripheriegeräten Positionsgrößen von 1 bis 12 	<ul style="list-style-type: none"> TE bietet eine große Auswahl an taktile Schaltern, von Miniatur-Oberflächenschaltern bis hin zu taktile Schaltern mit IP-Schutzart. Die taktile Schalter von TE sind in verschiedenen Aktuatorlängen erhältlich, die für jede Designanwendung eine maßgeschneiderte Funktion bieten. Wir bieten auch SIP-Switches an, die mehrere Widerstände und RAM-Chips mit einem gemeinsamen Stift bündeln können 	Schalter
Schiebeschalter 	<ul style="list-style-type: none"> In verschiedenen Konfigurationen und Größen erhältlich Die Schalter werden als SMD oder THT Version geliefert und sind in verschiedenen Winkel Stellungen erhältlich, um eine problemlose Bedienung zu ermöglichen 	<ul style="list-style-type: none"> Die Größen sind Subminiatur, Miniatur und Standard. Es gibt viele Anschlussvarianten für Schiebeschalter, einschließlich Durchführung, Kabel, Lötclennen, Schraubklemmen, Schnellanschluss- oder Flachstecker-Klemmen, Oberflächenmontagetechnik und Schalter für den Schalttafeleinbau 	Schalter
Mikro-/Schnappschalter 	<ul style="list-style-type: none"> Erhältlich mit verschiedenen Aktuator-Ausführungen und Montageoptionen Das Angebot an Snap-Produkten reicht von Miniaturausführungen bis hin zu Switches mit IP-Schutzart und Standardprodukten 	<ul style="list-style-type: none"> Große Auswahl an Optionen, einschließlich Block-, Tray- und Combo-Steckverbindern 	Schalter
Leistungseingangsmodul			
Gefilterte Eingänge 	<ul style="list-style-type: none"> Mehrere gefilterte Leistungsstufen Einrastbare und flanschmontierte Versionen erhältlich C-13-, C-14- und C-18-Eingänge bis 15 A C-20-Eingänge mit bis 20 A 	<ul style="list-style-type: none"> Mit geringen Verlusten ideal für medizinische Anwendungen Vielfältige Montageoptionen für mehr Flexibilität bei der Installation 	EMI-Filter

Produkt	Eigenschaften	Vorteile	Produktfamilie
Sensoren			
NTC-Thermistoreinheit 	<ul style="list-style-type: none"> • Standard-Widerstandsverhalten der Serie 400 • 1/4"-Standard-Telefonstecker • Nach Reinigung wiederverwendbar • Scheiben-Keramiksensoren • Hohe Empfindlichkeit gegenüber Temperaturänderungen • 316-Edelstahlrohr 	<ul style="list-style-type: none"> • Präzise • Anwenderfreundlich • Zuverlässig 	NTC-Thermistoren
RTD-Platin-Dünnschichtelemente 	<ul style="list-style-type: none"> • Präzise und stabile Temperaturmessung über einen breiten Temperaturbereich • Entspricht DIN EN 60751 • Sehr geringer Drift über die Lebensdauer • Kurze Ansprechzeit durch geringe thermische Masse • Verschiedene Umrissabmessungen verfügbar, um eine Vielzahl von Platzanforderungen zu erfüllen • Weltweite Austauschbarkeit 	<ul style="list-style-type: none"> • Ideal für Laborkalibriergeräte • Optimale Lösung für schnelle und präzise Regelungssysteme 	RTD-Temperatur Sensoren
Mikrothermoelement 	<ul style="list-style-type: none"> • Anschlussstypen, einfach und doppelt: J, K, T, E • Schaftdurchmesser: 0,188" • Schaftausführungen: Edelstahl, isolierter Edelstahl, isoliertes Epoxidglas, Kupferspitze • Führungsdraht-/Kabeloptionen • Einzel- und Doppeldiaphragma • Kundenspezifische Designs 	<ul style="list-style-type: none"> • Gut geeignet für enge Räume • Eigenstromversorgung 	Temperatur Sensoren
Analoger Infrarot-Thermosäulensensor 	<ul style="list-style-type: none"> • Berührungslös • Hervorragende Genauigkeit • Großer Temperaturbereich • Messbereich von -40°C bis +300°C • Infrarotfilter-Fenster 	<ul style="list-style-type: none"> • Kontaktlos • Geeignet für Handgeräte 	Thermopile-Infrarot-(IR-)Sensoren
Digitale TSYS0x-Sensoren 	<ul style="list-style-type: none"> • Digitaler Miniatur-Temperatursensor • Einstellung eines hochpräzisen Temperaturbereichs auf Anfrage • Niedriger Versorgungsstrom • Problemlose Anpassung an den verfügbaren Platz auf einem PC-Board • Geringe thermische Masse 	<ul style="list-style-type: none"> • Unkomplizierte Schnittstelle • Gute Genauigkeit und geeignet für batteriebetriebene Anwendungen 	Digitale Temperatur Sensoren

Unkomplizierte Möglichkeiten, um mit uns in Verbindung zu treten



[Weitere Ressourcen](#)

24/7

[24/7-Support](#)



[Online-Shop](#)



[Bestellung von Mustern](#)

te.com

AMPLIMITE Connectors, AMP, TE Connectivity, TE Connectivity (Logo) und Every Connection Counts sind Handelsmarken. Alle anderen hier aufgeführten Logos, Produkt- und/oder Unternehmensnamen können Handelsmarken der jeweiligen Eigentümer sein.

Die hier zur Verfügung gestellten Informationen, einschließlich Abbildungen, Illustrationen und schematischer Darstellungen, dienen lediglich zur Veranschaulichung und wurden nach unserem besten Wissen erstellt. TE Connectivity gewährt jedoch keinerlei Garantie bezüglich der Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben und lehnt jegliche Haftung für deren Gebrauch ab. TE Connectivity übernimmt nur die in den allgemeinen Geschäftsbedingungen für dieses Produkt festgelegten Verpflichtungen und haftet in keinem Fall für durch den Verkauf, den Wiederverkauf, den Gebrauch oder den fehlerhaften Einsatz des Produkts entstehende Begleitschäden, indirekte Schäden oder Folgeschäden. Die Nutzer von Produkten des Herstellers TE Connectivity müssen selbst beurteilen, ob das jeweilige Produkt für die jeweils gewünschte Anwendung geeignet ist.

© 2021 TE Connectivity Ltd. Unternehmensgruppe Alle Rechte vorbehalten.

05/21 Original